



团 体 标 准

T/CEMIA 038—2023

片式电阻器用低温固化包封浆料

Low temperature curable encapsulation paste for chip resistors

2023-11-14 发布

2023-12-30 实施

中国电子材料行业协会 发 布
中 国 标 准 出 版 社 出 版

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电子材料行业协会提出并归口。

本文件起草单位：西安宏星电子浆料科技股份有限公司、广东风华高新科技股份有限公司、中国振华集团云科电子有限公司、陕西华经微电子股份有限公司。

本文件主要起草人：赵科良、饶龙来、张艳萍、赵莹、曹秀华、袁志勇、谢强、罗彦军、赵云龙、甘建峰、南阳。

片式电阻器用低温固化包封浆料

1 范围

本文件规定了片式电阻器用低温固化包封浆料的技术要求、检验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存。

本文件适用于由功能填料、有机载体以及添加剂组成的能满足印刷特性的片式电阻器用低温固化包封浆料(以下简称:低温固化包封浆料)。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本规范必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6739—2022 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

SJ/T 11512—2015 集成电路用电子浆料性能试验方法

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 技术要求

4.1 低温固化包封浆料

低温固化包封浆料的外观、细度、黏度应符合表 1 的规定。

表 1 低温固化包封浆料性能

性能	外观	细度 μm	黏度 ^{a,b} $\text{Pa} \cdot \text{s}$
参数指标	色泽均一的膏状体、无沉淀	≤ 15	30~120
^a 黏度在 25℃ $\pm 1^\circ\text{C}$ 、Brookfield 14#转子、转速 10 r/min 条件下测得。			
^b 黏度范围内的具体数值由供需双方协商确定。			

4.2 低温固化包封浆料固化膜

低温固化包封浆料固化膜性能应符合表 2 的规定。